

# 普冉半导体（上海）股份有限公司

## “提质增效重回报” 2024 年度方案执行情况

### 及 2025 年度行动方案的报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“普冉股份”）于 2024 年 4 月 16 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 28 日披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。

公司在总结 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，以持续“强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力”为核心，紧密结合自身发展战略与经营现状，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

#### 一、“存储”“存储+”双战略并行带动业绩快速增长 市场份额持续扩大

2024 年，公司基于“存储”与“存储+”并行的战略，多产品线并举，保持高强度研发投入，重视产品研发创新和工艺深化，在原有存储芯片领域，继续拓展品类，加速产品迭代及产品性能和成本优化，并加强向工控、车规等领域发展的投入，持续扩大市场份额。同时，公司发挥特色工艺优势，延展“存储+”战略路径，持续增强公司的自主研发能力，加强公司人才梯队建设，推进 MCU 及 VCM Driver 等新产品技术与应用布局。

报告期内，全球半导体市场竞争激烈且形势多变，公司凭借敏锐的市场洞察力和高效的战略执行力，积极把握半导体设计行业景气度变化的契机，在下游市场需求回暖和终端应用创新的带动下，实现了业绩的快速增长。去年全年，公司实现营业收入 18.04 亿元，同比增长 60.03%，实现扣非前净利润 2.92 亿元，较上年同期增加 3.41 亿元，扭亏为盈；实现扣非后净利润 2.69 亿元，较上年同期增加 3.34 亿元。公司在产品、市场、供应链等多维度协同发力，积极应对市场挑战，优化业务布局，谋求稳健

发展与持续突破。

2025 年，公司将持续在产品研发创新、市场深耕拓展、成本优化控制等多方面协同发力，同时也将通过优化产品结构、拓展市场份额及提升运营效率等举措，进一步巩固行业地位，增强盈利能力与抗风险能力，持续以稳健的业绩表现回馈广大投资人。

## **1、“存储”产品线成为稳增长基石**

报告期内，公司实现存储系列芯片营业收入 14.17 亿元，同比上升 40.10%，毛利率 34.61%，同比上升 10.62 个百分点，出货量 67.72 亿颗，同比上升 33.09%，突破历史新高。

### **（1）NOR Flash**

作为公司营业收入占比最大的产品，公司的 NOR Flash 目前拥有 SONOS 和 ETOX 两种不同工艺路线，实现了 512Kbit~1Gbit 全容量覆盖，并在功耗、体积、可靠性等方面进一步优化，为客户提供各种应用场景下的产品选择。

**工艺制程：**公司 SONOS 工艺已成功推出 55nm 及 40nm 制程，第二代 40nm 制程产品已成为出货主力，广泛覆盖智能可穿戴市场；ETOX 系列，公司形成了 55nm 及 50nm 工艺下的全容量完整布局，打造出适用于不同电压的 ETOX 完整产品线，可适用于可穿戴设备、安防、工控等领域，已实现规模量产出货，未来将成为公司成长的重要动力之一。

**产品认证：**全容量 ETOX NOR Flash 系列产品通过 AEC-Q100 国际权威第三方的可靠性认证；中小容量 SONOS NOR Flash 车载产品陆续完成 AEC-Q100 认证，为公司在汽车电子领域的深入拓展奠定基础。

**市场应用：**公司推出的超低电压超低功耗新一代 SPI NOR Flash 系列新产品，支持 1.1V 电源系统，同时具备宽电压范围，可涵盖 1.2V 和 1.8V 系统，该产品系列计划覆盖 4Mbit-128Mbit 的容量区间，应用于基于嵌入式 SoC、手持移动应用、多媒体信息处理等场景中，能显著降低运行功耗，有效延长设备的续航时间。

此外，大容量 NOR Flash 成功导入品牌客户消费电子产品，如耳机、手表、手环等，在消费电子市场取得新突破；公司也持续推动全容量产品系列在工业控制、网络通讯、智能汽车等领域客户的进展，为产品在更多领域的广泛应用奠定了基础。

2025 年，公司将着眼于 SONOS 产品竞争力的持续提升，进一步拓宽产品应用领

域，并进行下一代工艺的技术创新储备；采用浮栅技术的 ETOX 产品，通过工艺研发和设计创新实现大容量产品完备化，支持广泛的产品应用和传统市场、新兴市场的全面覆盖，满足更多商用、工控、车载领域客户的需求。未来随着智能化硬件兴起对各类存储芯片需求的持续提升，公司出货量及容量等级亦会有一定量的提升。

## **(2) EEPROM**

**产品认证与市场应用：**公司车规 EEPROM 全系列产品均已通过 AEC-Q100 权威第三方测试，产品在可靠性和稳定性方面得到了国内外诸多客户的认可。截止 2024 年底，公司 EEPROM 产品在车载摄像头出货的基础上，新增车身域控、车载无线充、电机控制、电池 BMS、车载中控、娱乐系统等汽车电子应用场景，实现了多个头部客户的批量交付，在汽车电子领域的市场份额得到了有效拓展，汽车电子产品营业收入占比有所提升。

**产品技术与性能：**推出的超低电压 1.2V 系列 EEPROM 已实现量产出货，涵盖 32Kbit 至 512Kbit，是目前行业内工艺节点领先和容量覆盖面较为完备的超低电压产品线，能满足对低电压、低功耗有较高要求的应用场景需求。

**产品封装：**基于市场对产品小型化封装和高可靠性的需求，推出了全阵容 WLCSP 封装系列产品，给手机摄像头客户提供更全面的封装选择，同时能有效降低芯片加工过程中产生的裂片和颗粒缺陷的风险，降低产品使用过程中可能发生的潜在失效，提升了公司产品的市场竞争力。

2025 年，公司将继续拓展优势领域市场份额，深耕手机摄像头市场，推进新客户及新项目导入。随着工业三表市场智能化进程加速，公司将继续凭借 EEPROM 产品高可靠性、宽电压等特性，提高在工业三表市场的渗透率。公司也将积极抓住车规芯片智能化及国产替代趋势，持续推进在汽车电子领域的导入及放量。同时，也进一步挖掘 EEPROM 在其他领域的应用场景，如工控、通信等市场，凭借产品的低电压、高可靠性、小封装等优势，满足更多客户的需求。

## **2、“存储+”产品矩阵持续完善 打开成长新空间**

公司大力推进“存储+”战略，该系列产品在 2024 年实现营业收入 3.86 亿元，同比增长 234.58%，毛利率 29.63%，同比上升 2.75 个百分点，出货量 8.70 亿颗，同比上升 213.79%，成为公司新的业绩增长引擎。

## **(1) MCU**

公司借助设计与工艺的协同优势，在先进逻辑工艺平台优化嵌入式存储器技术，并构建通用高性能和高可靠性的 MCU 产品平台。过去三年公司在智能消费电子和工业控制等领域持续布局，品牌知名度迅速提升，实现了快速发展，2024 年，全年出货量近 8 亿颗，2022 年出货至今，总出货量超过 11 亿颗。

截至报告期末，公司 MCU 产品已成功量产 5 大系列、百余款产品供市场选择，构筑了更加完善的产品矩阵。2024 年，公司的 MCU M0+产品系列，在运行功耗和待机功耗上均有效降低，实现了高可靠性和低功耗并重。MCU M4 产品提升了系统在复杂环境下的可靠性与响应能力，更适用于电机控制、智能穿戴、电池管理系统(BMS)、IOT 等应用领域。

此外，公司中高端系列及高性能触控系列新产品推出并实现量产出货，广泛应用于智能家居、消费电子等领域，与存储产品形成了良好的出货协同效应，更好地满足不同客户和市场的多样化需求。

公司重视基于硬件技术之外的软件及生态等综合竞争力提升，通过扩充相关支持团队等方式持续推进 MCU 生态环境建设，如重要客户方案设计、FAE 现场支持、工具开发、驱动程序推出、客户开发环境、网站支持等方面都积极配合实施推广。公司给予客户全面的软硬件支持及配套资料，使得公司的 MCU 潜力可以被开发者充分挖掘，从而高效快速地推进项目，加速客户产品开发周期。

## **(2) Driver 产品**

报告期内，公司内置非易失存储器的 PE 系列音圈马达驱动芯片（二合一）实现多颗产品大批量出货，支持下一代主控平台的 1.2V PD 系列音圈马达驱动芯片也已量产出货。OIS VCM Driver 产品在国内终端实现量产，满足以手机应用为主的核心客户需求。在此基础上，公司推出新一代 OIS VCM Driver 产品，更新升级了具有普冉专利的音圈马达防抖控制算法与客户定制的专有功能，为未来的快速增长做好了准备。VCM Driver 产品与公司 EEPROM 形成协同效应，在手机摄像头模组领域更好地为客户提供整体方案，提升了公司在该领域的竞争优势，有助于获取更高的市场份额。

同时，公司 MCU 与预驱一体式的电机驱动控制芯片实现量产和规模化应用，广泛用于运动控制、电动工具、园林工具、白色家电、智能小家电等应用场景。

2025 年，公司将重点围绕通用微控制器芯片产品开展“存储+”系列的深度研发，

进一步优化产品性能和功能，推出更多满足市场需求的产品，覆盖从入门级到中高端等多种应用场景，以适应市场需求和技术发展趋势。同时，公司将在芯片封装优化上发力，MCU 产品线支持 20~100 IO 的多种封装形式，协同晶圆代工厂和封测厂，全方位提升封装质量、效率和竞争力，以满足市场对 MCU 产品多样性不断增长的需求，保障业务的持续发展。

此外，持续推动模拟及其他产品线的发展，加大资源投入，开发出更多适应市场需求且与公司既有业务可深入协同的产品，继续深化与现有客户的合作，进一步提高市场份额，巩固公司在智能消费电子领域的市场地位，同时开拓在新兴市场领域的业务可能性。提升“存储+”系列产品在公司营业收入中的占比，使其成为公司长期发展的动力之一。

### **3、高度重视研发投入 持续推动技术创新**

公司始终如一地高度重视研发创新。2024 年，公司研发投入达 2.42 亿元，较去年同比增长 26.49%，占营业收入的 13.42%。。研发团队规模进一步扩大，新增研发人员覆盖芯片设计、工艺研发、测试验证等多个领域。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术，并形成了有规划、有策略的专利布局。报告期内，取得 20 项发明专利，2 项实用新型专利授权；新提交 47 项发明专利，6 项实用新型专利申请；取得 9 项集成电路布图设计登记。截至 2024 年末，公司已获授权的发明专利达 56 项，集成电路布图设计证书 55 项，获授知识产权累计总数达 122 项，建立起了完整的自主知识产权体系。

公司作为行业内为数不多的同时具备 NOR Flash、EEPROM 和 MCU 产品线的芯片设计公司和极少数掌握工艺技术的 Fabless 厂商，将继续探索以存储为核心的产品迭代和工艺优化，推动创新的技术储备。同时，延展“存储+”战略路径，持续增强自主研发能力，并注重生态体系的构建，推进新产品技术与应用布局，构筑行业领先的成本控制能力和面向通用产品领域的长期竞争力，以更好的产品回馈客户与终端消费者。

## **二、市场拓展成效显著 品牌力持续加强**

### **1、坚定拓展海内外市场 重点关注大客户拓展**

作为行业领先的 Memory 供应商以及新晋的 MCU 供应商，普冉股份在 2024 年，

于市场拓展层面积极进取。在国内，公司凭借多年深耕，构建起稳固的客户网络，NOR Flash、EEPROM、MCU 等各产品线相互协同，实现客户资源的高效共享。自 2016 年成立至 2024 年末，公司存储产品累计出货量近 280 亿颗；自 2022 年推出“存储+”产品以来，相关产品累计出货量超过 12 亿颗，在消费电子、工控、通讯、汽车电子等领域积累了众多客户。

2024 年，公司在国内市场份额快速增长的同时，大力进军海外业务，持续推进全球化布局，在 APEC、EAME 地区均与海外客户建立起了紧密联系。公司通过差异化、大客户优先、中小客户全面展开等战略并举，抢占存储复苏先机，在全球市场的品牌影响力显著提升。

展望 2025 年，公司将全方位深化市场拓展工作。国内市场，进一步挖掘现有客户潜力，拓展产品应用领域，针对不同行业客户的需求，制定产品解决方案。海外市场方面，持续加大投入，在巩固现有市场份额的基础上，细化目标市场，实施区域化战略，以工业级以上产品开拓欧美市场，以本地化服务在日韩、印度等亚太地区抢占先机，并在中东等新兴市场等地提前布局，构建品牌影响力。同时，针对智能化领域的新兴终端涌现，凭借公司存储芯片在手机、电脑、耳机、可穿戴等消费电子市场，以及光模块、服务器、基站等工控及通信市场积累的合作资源，积极与海内外相关企业建立联系，推动公司产品在各类智能化终端场景的应用。

## **2、品牌声誉持续提升 为公司市场外拓注入活力**

2024 年，公司积极参与行业展会，获得了多家主办方及评选单位的各类奖项，进一步增强了品牌曝光度与行业影响力：

参展 IIC Shanghai2024，荣获“2024 中国 IC 设计成就奖之年度创新 IC 设计公司”；

于 AspenCore2024 中国 IC 设计 Fabless100 排行榜中，获评“100 家上市公司综合实力和增长潜力排名 Top34”及“Top3 存储器公司”；

参加 ellexcon2024 深圳国际电子展，荣获了“2024 年度市场卓越表现奖”之“2024 年度市场创新突破奖”；

于 2024 第十一届 IoT 大会上荣获“IoT 市场突破表现企业奖”；

荣获“2024 上海证券报金质量奖科技创新奖”；

荣获“2024 年上海市重点服务独角兽（潜力）企业”。

2025 年，在品牌建设上，公司将规划参加国际集成电路展览会暨研讨会（IIC Shanghai）2025、上海慕尼黑电子展、深圳国际电子展 elexcon2025 等多场知名行业展会，展示公司的最新产品与技术成果，全方位提升公司品牌的市场知名度与美誉度，助力各产品线实现更大规模的销售增长。

### **3、业务、资本深入共振 为外延式发展注入动能**

公司以自有资金参与华大九天 A 股 IPO 战略配售，双方已形成的战略业务合作使得公司在 EDA 领域有了更多的国产化选择。报告期内，公司亦受益于华大九天良好的资本表现，获得了投资收益。同时，公司参与投资的季丰电子营运表现良好，为公司提供了优质的服务，发挥了上下游产业链协同效应。

此外，报告期内，公司参投上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金和珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）私募基金，通过合作专业的投资机构，专注于主营业务相关技术、市场具有高度协同性的泛半导体领域，以期获得较好的投资回报，并探寻潜在的规模化成长路径。

2025 年，公司将继续围绕主营业务，持续关注业务与资本协同发展的机制，运用资本市场工具，为公司积蓄新的增长点。

## **三、精细化管理降本增效 协同优化供应链资源 推动募投项目顺利实施**

### **1、财务管理成效显著 成本管控持续深化**

报告期内，公司合理管控各项费用，尽管随着规模以及产品线的扩大，研发费用、管理费用和销售费用同比有所增长，但因收入增长带来规模效应，费用占销售收入比率同比分别减少 3.56、0.86 和 0.36 个百分点。此外，随着下游市场景气度提升和公司整体存货管理能力的提升，资产减值损失同比较去年减少 1.02 亿元。

公司实施较为严格的账期管理政策，积极回笼资金。截至 2024 年末，应收账款周转次数为 5.22 次，相比于去年的 4.12 次有显著改善；同时，公司综合考量需求预测、安全库存、投产规划、供应链协调、风险管控等因素，实施灵活可控的生产备货策略，合理应对原材料及封测单价变化，有效控制了成本，毛利率较 2023 年度有明显提升。

2025 年，公司将持续关注市场动态与行业周期变化，从设计、生产、采购等环节

入手，继续深化成本管控策略。在产品设计环节，优化产品架构，在保证产品性能的前提下，继续缩小芯片面积；生产环节，与晶圆厂保持紧密合作，持续提升工艺水平，提高产品良率，降低单位生产成本；采购环节，加强与供应商的战略合作，通过集中采购、灵活协议等方式争取更有利的采购价格，同时优化库存管理，减少库存积压，降低库存成本。

## **2、供应链优化提升效率 产能保障稳定供应**

2024 年，公司供应链管理成效显著。公司与国内主要晶圆厂商、封测厂保持战略合作，确保了供应链产能安全。公司持续推进既有和新产品领域的供应商考评和引入工作，建设高弹性、低成本、可持续的供应链体系。同时，公司完善供应链风险预警机制，加强对代工价格波动、供应商产能变化等风险的监测与应对。2024 年，随着供应链管理的优化，资产减值损失因存货管理更合理等原因同比大幅降低。并且在下游市场需求增长时，公司能够较好地协调供应链，保障供应及产品交付，满足市场对公司产品的需求，并实现与供应商的双赢。

产能方面，公司根据市场需求预测，提前与晶圆厂商等合作方规划产能扩充。在现有成熟工艺产能稳定供应的基础上，为市场拓展与新产品的推出做好产能准备，以应对市场可能出现的需求波动，保障产品稳定供应。

2025 年，公司将进一步巩固与现有供应商的合作关系，建立更紧密的信息沟通机制，实现需求与供应的精准匹配。同时，公司将丰富供应链资源，降低单一供应商依赖风险；针对不同产品线的特点与需求，制定差异化的供应链管理方案，确保各产品线供应稳定、高效。基于已经引入的供应链管理系统，持续提升供应链协同效率与应急响应能力，同时加强与供应商在技术研发、产品质量提升等方面的合作，共同推动产业链的协同发展。

## **3、募投项目顺利实施 助力公司强化盈利水平**

公司首发上市募集资金净额 12.46 亿。截止 2024 年年底，公司《闪存芯片升级研发及产业化项目》和《EEPROM 芯片升级研发及产业化项目》两个募投项目已结项，项目的研发成果丰富了公司的存储产品系列，并持续对公司的产品开发产生正向影响。公司《总部基地及前沿技术研发项目》和《基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项

目》尚在持续进行。其中，在《总部基地及前沿技术研发项目》实施过程中，随着公司业务规模的不断扩大和研发项目的日渐增多，公司计划增加可靠性实验室场地建设面积，用于提升公司研发实力，为公司产品升级迭代以及新产品、新技术研发提供支持，公司以超募资金追加投资 17,797.73 万元，并经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。以上募投项目助力公司“存储+”产品线长足发展和公司规模的持续扩大。截至报告期末，除超募资金外，募投资金在募投项目中的使用比例已超过承诺投资总额的 76.93%，为公司未来新产品新技术的研发，以及业务领域的拓展提供了必要的技术和研发资源支撑，为公司技术驱动业务发展的战略提供了保障。

2025 年，公司将继续加快推进募投项目建设，争取早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。同时，公司将在目前业务稳步增长的同时，合理利用超募资金拓展业务创新机会，持续关注行业发展趋势，为客户提供更优质的产品，发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。

#### **四、激励与机制协同发力 稳步培养高素质人才团队**

##### **1、重视员工激励 激发自主能动性**

公司高度重视人才培养与团队建设。截至 2024 年末，公司员工总数增长至 432 人，相较于 2023 年的 353 人增加了 79 人，博士及硕士占比达 27%，本科占比 63%，本科以下学历占比 10%。

公司采用具有竞争力的薪酬体系与股权激励计划吸引和留住人才，2024 年研发人员平均薪酬达 67.64 万元，较去年同期增长 8.87%。报告期内，公司向 76 名激励对象授予 45.75 万股第二类限制性股票，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 70%以上，使员工与公司利益紧密相连，激发员工能动性与创造性。

未来，公司将持续优化薪酬福利体系，依据市场行情与行业水平，适时调整薪酬结构，确保公司薪酬具备竞争力，吸引更多半导体领域优秀人才加入。此外，公司计划于 2025 年进一步实施全员股权激励，并根据公司实际情况完善激励机制，充分调动员工积极性与创造力，提升员工对公司的归属感与忠诚度。同时，公司将完善绩效奖励制度，建立更加科学合理的绩效考核指标体系。加大对核心业务部门、关键岗位员工的绩效奖励力度，突出业绩导向，营造积极向上的工作氛围。

## **2、多方式实施人才培养 关注职工成长需求**

2024 年，公司继续实施全方位培训计划，根据业务及研发上的实际需求规划全年培训次数 60 余次，覆盖 1218 人次，包含新员工入职、专业技能、通用能力、管理能力等方面的专题培训。公司持续优化员工绩效评估体系及晋升机制，充分调动员工工作积极性，激励员工不断提升专业技能与综合素养，助力员工实现职业发展目标。

此外，2024 年，公司积极开展企业导师带教项目，通过一对一或小组辅导的形式，为新人及潜力人才提供了直接向经验丰富的前辈学习的机会，加速了其专业技能、业务理解及领导力的成长。通过导师制度的实施，公司能更有效地加速人才成长、传承专业知识、激发创新活力、增强团队凝聚，同时塑造公司的企业文化。

同时，公司 2024 年度首次跟名校合作进行研究生的校企联合培养。通过整合学校与企业两种不同的教育环境和资源，让学生在接受理论知识的同时，能直接参与企业的实际项目和工作，从而提高其综合素质和专业能力。校企联合培养模式下，学校与企业间的合作不仅限于人才培养，还拓展到了科技创新和成果转化等领域。学校可以为企业提供技术支持和人才支持，帮助企业解决技术难题，提高产品质量和竞争力。这对于芯片设计公司有着重要的意义，也是公司培养高学历高技能人才的有效模式。

2025 年，公司将积极尝试扩大校企联合培养规模，与高校建立长期稳定合作关系，员工福利方面，持续开展多样化员工活动，如团队拓展、文体竞赛、节日庆祝等，增强员工之间的沟通交流与团队凝聚力。完善员工职业发展通道，为员工提供清晰的晋升路径与发展规划，关注员工职业成长需求，营造积极向上的企业文化氛围。

## **五、高效开展投资者互动 切实重视投资者回馈**

### **1、多元化推进投资者互动 增强投资者信任**

2024 年，公司基于定期报告，积极举办线上、线下的说明会，诚挚邀请投资者、分析师参加。全年组织投资者调研超过 100 场次，召开定期报告业绩说明会 4 次以上，广泛邀请投资者、分析师等参与，通过多种方式积极与投资者交流互动，显著增强了投资者对公司的了解和信任。

同时，公司严格按照信息披露规则，及时、准确、完整地披露公司定期报告、重大事项等信息，通过公司官网、交易所指定信息披露平台等渠道，确保投资者第一时

间获取公司信息。

公司积极搭建多元化沟通渠道，保留传统电话、邮箱沟通方式外，还充分利用公司官网投资者关系板块、上证 e 互动、微信公众号等新兴渠道。在 2024 年，公司通过上证 e 互动平台及时回复投资者关心的问题，回复率高达 100%，平均回复时间控制在 1 个工作日以内。公司官网及官方公众号等投资者关系板块定期更新公司动态、业绩报告、产品创新等资讯信息，为投资者深入了解公司提供了权威和便捷途径。公司采用图文、视频、线上会议等形式，提高定期报告的可读性、实用性。公司在 2024 年半年度报告披露后，及时于公众号发布解读长图文，并在 2023 年年报、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告披露后通过上证路演中心，采取可视化财报、视频的方式对报告的重点内容进行解读，提高定期报告的可读性、实用性。公司收获了较高市场认可度，2024 年同花顺上市公司评选，公司荣获最具人气上市公司 TOP100。

2025 年公司将持续围绕提升透明度、强化投资者关系、优化市场反馈机制三大目标展开。在具体规划上，通过定期报告沟通、投资者调研活动、交流会议、新媒体平台互动及其他投资者活动等多种形式实施。执行层面，组建专门工作小组，制定详细时间进度表；评估环节，建立完善指标体系，根据结果持续优化调整，以实现公司与投资者的良性互动与共同发展。

## **2、树立以投资者为本的发展理念 强化投资者回报**

2024 年 4 月，公司披露了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 105,609,735 股，并于 6 月 6 日完成除权除息。

2024 年 8 月，为响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为合理回报投资者，增强投资者对公司的投资信心，实施“提质增效重回报”专项行动方案，构筑以价值创造和互利共生的双赢格局，使各方更紧密的合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司实施了中期分红安排，在半年度盈利的基础上，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，拟以

2024 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

上述分红及转增方案将在 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

公司通过增强分红稳定性、持续性和可预期性，提高公司的股息率，保护中小股东的利益与诉求，增强投资者对公司的信心。

2025 年，公司会继续充分结合公司资金使用安排、经营发展需要以及业务战略目标，深入讨论利润分配、回购等回报投资者的方案和可行性，合理提高分红率和股息率，切实维护广大股东的合法权益。

## **六、强化公司治理架构 优化内控管理流程**

报告期内，公司持续完善内部控制体系制度，紧密跟踪相关法律法规的变化，及时对公司相关内部控制制度进行更新，确保公司制度严格符合当下法律层面的合规要求。围绕基本内部制度，建立起更为精细化的流程和管理机制，有效防范了经营及内部控制风险。新增多项内控制度，涵盖合同管理、项目管理、信息安全等关键领域，内部审计部门独立开展工作，定期对公司财务收支、内部控制、重大项目等进行审计，充分发挥监事会的监督职能，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障公司规范运作。

2025 年，公司将持续完善公司治理结构，优化董事会、监事会运作机制。重大决策事项通过充分的调研、论证与集体决策，提高决策科学性与准确性。加强内部审计监督，内部审计部门独立开展工作，定期对公司财务收支、内部控制、重大项目等进行审计。同时，充分发挥监事会的监督职能，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障公司规范运作。进一步规范公司决策流程，加强决策前的调研论证工作。建立决策跟踪与评估机制，对重大决策事项的执行情况进行跟踪评估，及时调整决策偏差，提高决策执行效果。

综上所述，2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展。公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量，加强投资者关系管理与维护，切实保障了投资者合法权益。

公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日